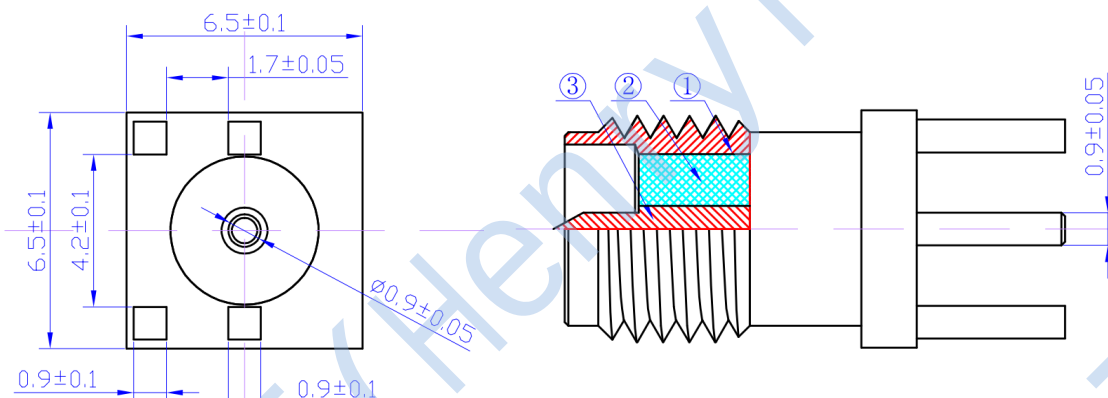
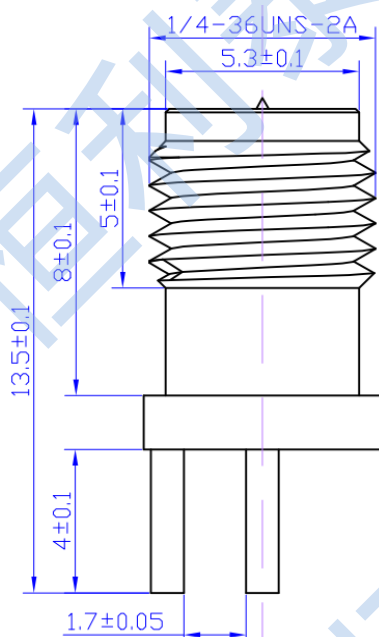


A

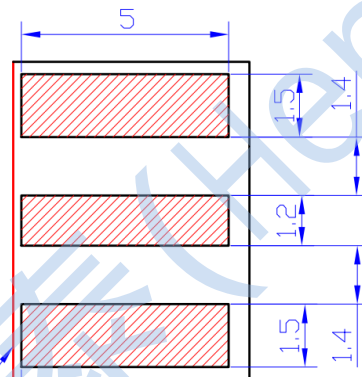


B

C

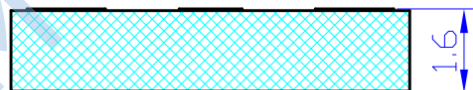


建议焊盘尺寸
(Suggested PCB Layout)



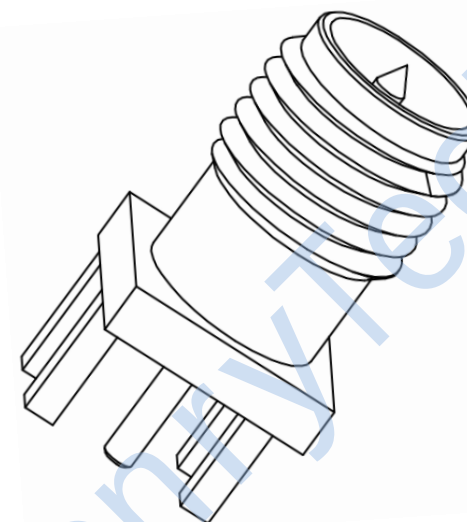
PCB板外边
(PCB Board Edge)

焊盘覆铜尽量至PCB板边
(It is recommended to extend the copper pour from the pads as close as possible to the PCB board edge.)



此连接器适配于1.6mm厚度的PCB板
(This connector is designed for
1.6mm thick PCBs.)

材质与表面处理(Materials & Plating)			
序号(Serial)	零件名称(Part Name)	材质(Material)	表面处理(Plating)
1	壳体(Body)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)
2	绝缘子(Insulator)	聚四氟乙烯(PTFE)	
3	中心孔针(Contact Pin)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)
性能指标(Electrical)			
1.特性阻抗(Impedence) : 50Ω			
2.频率范围(Frequency) : DC-6GHz			
3.接触电阻：内导体(Center Contact Resistance) ≤ 3mΩ Contact Resistance) ≤ 2mΩ			外导体(Outer
4.绝缘阻抗(Insulation Resistance) : ≥ 5000MΩ			
5.介电耐压(Dielectric Withstanding Voltage) : 1000V(Volts RMS)			
6.驻波比(VSWR) : ≤ 1.3			



D

零件代号	
------	--

借(通)用件登記

描图

描校

旧底图总号

底图总号

答字

一般公差			
(尺寸单位: mm)		(角度单位: °)	
X.	±0.20	XX.	±2°
.X	±0.15	X.	±1°
.XX	±0.08	.X	±0.5°

								 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			
标记 处数		分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	HL-RPSMA-KE-13.5	
设计			标准化							-02	
校核			工艺								
主管设计			审核								
			批准			共1张 第1张		版本		替代	